

Novoflex Pte Ltd為電訊行業推出顛覆性的SIM卡組裝工藝

- 大大簡化卡片組裝工藝，並消除對基板的需要。
- 為卡片製造商和運營商節省了大筆開支
- 使用新工藝組裝的 **SIM** 卡，乃是由印度和印度尼西亞領先的流動運營商發行
- 在全球獲得專利；來自全球各地的主要**SIM**卡供應商爭相採購

新加坡，2017年11月1日 - 新加坡智能卡創新者NovoFlex今日宣佈推出Secure Authenticable Identification Laminates

(sAiL)TM，這是一種獲得專利、開創性的新技術流程，重新定義了集成電路(IC)晶片嵌入到目前在電訊行業使用的SIM卡中的方式。Novoflex與印度的智能卡製造商Eastcompeace及印度尼西亞的CIPTA攜手合作，在這些國家主要流動運營商發行的SIM卡中採用C晶片。

該工藝透過消除兩個主要步驟（模塊封裝和模塊嵌入），脫離SIM卡的傳統製造方法。sAiLTM採用一層薄薄的塑料薄膜，其彈性外形也支援集成到一系列日常用品中。

再加上該流程在所有步驟中需要更少的黃金，這種新技術為卡片製造商大幅節省了成本。由於該流程與現有的卡片製造機器相容，因此sAiLTM可以立即集成到當前的智能卡組裝工藝中。

Eastcompeace India Pvt

Ltd董事總經理RajnishGiri說：「Eastcompeace以成為早期採用創新型新技術和流程的公司感到無比自豪。sAiLTM

在SIM卡的生產流程中取得了巨大的飛躍。我們也對在電訊行業以外運用sAiLTM的可能性感到興奮不已。」

CIPTA行政總裁Steven

Chandra說：「我們在CIPTA的使命是利用創新技術來增強普通人的能力。過去幾年在創新的推動下，智能卡的應用在各個行業中不斷開花結果。sAiLTM等技術改變了遊戲規則，我們很高興與NovoFlex等戰略合作夥伴合作，幫助我們構想一個更光明、更大膽的未來。」

該工藝已在20個國家/地區成功獲得專利，並在更多的國家申請專利，同時獲得了全球主要SIM卡供應商的關注。儘管電訊行業對sAIL™有著初步需求，但NovoFlex已與主要業者合作，將sAIL™技術運用於銀行卡，並相信其使用將在不久的將來擴展到交通運輸和物聯網(IoT)行業。

NovoFlex行政總裁Eric

Ng博士說：「我們在NovoFlex的使命是提供賦能技術使對象更智能。sAIL™提供安全身份驗證，首先應用於電訊領域，由於其靈活性，未來可以應用於更多的行業。我們非常自豪地透過合作夥伴在印度和印度尼西亞推出這項新技術，並希望能夠在電訊之外領域迅速擴張。」

關於 Novoflex

Novoflex 是一間總部設於新加坡的公司，專注於推動智能卡行業不斷實現創新。Novoflex 與由集成晶片製造商、支付公司、設備製造商、組裝和測試公司以及智能卡提供商組成的良性系統開展合作，以求不斷推出專利技術，適用於電訊、銀行和交通運輸行業以及物聯網 (IoT) 領域應用。

網址：www.novoflex.com.sg

媒體查詢：

Pang Sze Yong

Novoflex Pte Ltd

手機：65-90058567

sypang@novoflex.com.sg

K. Dorai Raja

ContentWerkz Pte Ltd

手機：65-97466010

電郵：raja@contentwerkz.com